

# 글로벌 반도체 경쟁력 선점을 위한 재정투자 강화방안

2025. 4. 15.

관 계 부 처 합 동

# 글로벌 반도체 경쟁력 선점을 위한 재정투자 강화방안(요약)

## 1 추진 배경

- 시스템 반도체 분야 국내 기반이 취약하고 美 신정부 출범 후 불확실성이 증가하는 가운데, 정부 지원에 대한 업계 목소리 확대
  - 반도체 기업 지원을 위한 「반도체특별법」이 국회 계류 중으로, 반도체 시장 선점에 필요한 골든타임을 놓칠 우려

☞ 글로벌 반도체 경쟁에서 **국내기업이 겪는 애로**를 해소하기 위한 **적극적 재정투자 방안** 마련

## 2 추진 과제

◇ **민간 중심의 활력있는 반도체 혁신·성장 생태계 구축 위해 반도체 분야 투자를 26조원 → 33조원으로 확대**

### 1. 인프라 구축

- (송전선로 지중화 지원 신설) 용인·평택 반도체 클러스터 적시 조성 위해 기업이 부담하는 송전선로 지중화 비용의 70% 국비 지원
- (첨특단지 인프라 지원한도 확대) 투자규모 100조원 이상 대규모 클러스터에 대해 인프라 국비지원 한도를 500→1,000억원으로 확대
- (첨특단지 인프라 지원비율 상향) 첨특단지 인프라 국비지원 비율을 기존 15~30% → 30~50%로 상향

### 2. 소재·부품·장비 투자 지원

- (소부장 투자보조금 신설) 국가첨단전략산업\* 공급망 안정품목·전략물자를 생산하는 중소·중견기업 대상 투자보조금 신설
  - \* 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 등 4개 산업
- 소부장 중소·중견기업 입지·설비 신규 투자규모의 30~50% 지원(전당 150억원, 기업당 200억원 한도)

- ☐ (반도체 분야 20조원 금융투자) 기존 반도체 저리대출(17조원)을 3조원 이상 추가공급하여 반도체 분야에 20조원 이상 투자('25~'27년)
- ☐ (반도체 중소기업 기술보증 확대) 반도체 분야 중소기업에 대한 기술보증비율(기본 85→95% 이상) 및 한도(100→200억원) 확대
- ☐ (반도체 투자세액공제율 상향) 반도체 투자세액공제율 5%p 상향

### 3. 차세대 반도체 개발

- ☐ (팹리스 공동활용 장비 확충) 고가의 AI반도체 실증장비를 팹리스들이 공동활용할 수 있도록 공공인프라 내 구축 확대
  - 시제품 제작 전 설계 오류 검증 장비를 추가 구축하고('26~), 시제품 제작 후 실증 장비 연내 신규 구축(2대)
- ☐ (첨단반도체 양산연계형 미니팹) 용인 반도체 클러스터 내 실제 양산 환경에 근접한 미니팹\*을 구축하여 소부장 기업 실증 지원
  - \* 반도체 소재·부품·장비를 테스트할 수 있도록 반도체 전공정 생산설비 구축
  - 반도체 기업-소부장 기업 간 협력, 산학연 현장형 전문 인재 양성 등 K-반도체 혁신생태계(한국형 IMEC) 조성 추진
- ☐ (스타팹리스 육성 확대) 차세대 반도체 분야에서 기술혁신 역량과 글로벌 성장잠재력을 보유한 스타팹리스 5개사 추가지원(15→20개사)
- ☐ (AI반도체 트랙레코드 확보 지원) 국산 AI반도체 조기상용화 위해 대규모 수요창출 중심의 트랙레코드 확보 지원 확대

### 4. 우수인재 확보

- ☐ (국내 신진 석박사 연수·연구 신설) 국내 신진 석박사들에게 일경험이 될 수 있는 기업 수요형 과제 수행 연수·연구 프로그램 신설
- ☐ (해외 고급인재 유치 신설) 해외 전문기술인력, 최고수준 우수인재 유치 위한 국내 체류형(in-bound) 글로벌 공동연구 프로그램 신설
- ☐ (반도체 아카데미 확대) 지방 반도체 기업의 안정적 인재 확보 위해 반도체 아카데미를 수도권에서 전국으로 확대

## 순 서

I. 추진 배경 .....	1
II. 추진 전략 .....	2
III. 4대 추진 과제 .....	3
1. 인프라 구축 .....	3
2. 소부장 투자 지원 .....	5
3. 차세대 반도체 기술개발 .....	7
4. 우수인재 확보 .....	9
IV. 향후 추진계획 .....	10

# I . 추진 배경

## □ 글로벌 반도체 경쟁에 대응, 「반도체 생태계 지원 방안」 등 발표

- 첨단기술 선점, 경제안보 강화 위한 글로벌 반도체 경쟁 심화
- 우리 정부도 「반도체 생태계 종합지원 추진방안」(‘24.6월) 등을 통해 금융·재정·세제·인프라 등 지원책 마련(총 26조원 규모)

< 반도체 생태계 종합지원 추진방안(‘24.6) >

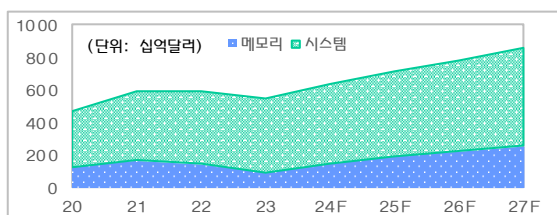
분야	주요 내용
■ 금융	17조원 저리대출 프로그램 신설, 반도체 생태계 펀드 확대(0.3→1.1조원)
■ 세제	국가전략기술 세액공제 적용기한 3년 연장, R&D 세액공제 범위 확대 등
■ 재정	R&D·인력양성 등에 대한 재정지원 확대(‘25~’27, 5조원 이상)
■ 인프라	정부·공공기관이 협력하여 신속한 인프라 구축 지원

- ‘25년 반도체 저리대출 4.25조원 공급, 반도체 세액공제 확대 등 추진 중이나, 기업들의 부담 완화 위한 추가지원 필요

## □ 시스템 반도체 기반 취약, 美 新정부 출범 등으로 불확실성 증가 → 정부 지원에 대한 업계 목소리 확대

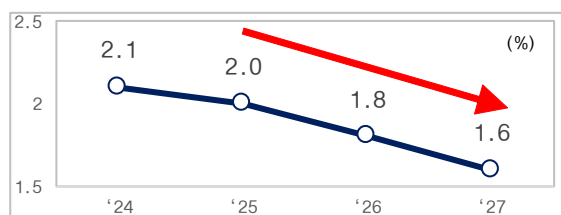
- 글로벌 시장이 확대되는 시스템 반도체 분야 국내 기반 취약, 메모리 분야 中 추격 등으로 글로벌 반도체 선도 입지 위협

메모리·시스템반도체 글로벌 시장규모



\* OMDIA, '24.3월

한국 시스템반도체 점유율 전망



\* 차세대지능형반도체사업단, '25

- 美 新정부 출범 후 관세인상 예고 등 정책변화\*에 따른 불확실성 증가

\* 「반도체과학법」상 보조금 축소 가능성, 對中 반도체 수출통제 강화 등

- 반도체 기업 지원을 위한 「반도체특별법」이 국회 계류 중으로 반도체 시장 선점에 필요한 골든타임을 놓칠 우려

☞ 글로벌 반도체 경쟁에서 **국내기업이 겪는 애로**를 해소하기 위한 **적극적 재정투자 방안** 마련

## Ⅱ. 추진 전략

목표

민간 중심의 활력있는 반도체 혁신·성장 생태계 구축  
- 반도체 분야 투자를 26조원 → 33조원으로 확대

기본  
방향

글로벌 반도체 경쟁에 소요되는 막대한 비용으로 인해  
기업이 겪는 어려움을 재정의 마중물 투자를 통해 해소

4대 추진 과제	분야	추진방향	15개 세부과제	규모
	인프라	기업 구축비용 과도 → 전력 등 인프라 적기 구축 지원	① 송전선로 지중화 지원 신설 <sup>신규</sup> ② 대규모 첨단단지 인프라 지원한도 상향 ③ 첨단단지 인프라 지원비율 상향	3.1→ 5.1조
	투자	기업 투자 여력 부족 → 보조금, 대출, 보증 등 투자 자원 보강	④ 소부장 중소·중견 투자보조금 신설 <sup>신규</sup> ⑤ 첨단전략산업기금 신설 <sup>신규</sup> ⑥ 반도체 중소기업 기술보증 확대 ⑦ 반도체 투자세액공제율 인상(5%p)	18.1→ 21.6조
	차세대 기술	신시장 창출 지원 → 차세대 반도체 개발 신속 지원	⑧ 팹리스 기업 고성능 장비 확충 ⑨ 양산 연계형 미니팹 구축 ⑩ 차세대 반도체 핵심 기술개발 조기 달성 지원 ⑪ 스타 팹리스 육성 확대 ⑫ AI반도체 트랙레코드 확보 지원	3.8→ 5.0조
	인재	핵심인재 유출 우려 → 우수인재 확보 지원	⑬ 국내 신진 석박사 연수·연구 신설 <sup>신규</sup> ⑭ 해외 고급인재 유치 프로그램 신설 <sup>신규</sup> ⑮ 반도체 아카데미 전국 확대	1.4→ 1.4조

### Ⅲ. 4대 추진 과제

#### 1. 인프라 구축

##### ① 반도체 메가클러스터 송전선로 지중화 국비지원 신설 신규

○ **(현황)** 용인·평택 반도체 클러스터 조성 중이나, 송전 인프라 구축에 약 4조원 소요되어 기업의 비용 부담 과다

- 특히, 용인·평택은 인구밀집지역으로 신속한 인프라 구축을 위해서는 송전선로 지중화\* 필요(전체 비용의 60% 수준 예상)

\* 평택(신평택-고덕#3), 용인(서안성-신이동 등 4개) 등 5개 선로 지중화 추진중(협약完 기준)

⇒ **(지원방안)** 대규모 침투단지가 적시에 조성될 수 있도록 기업이 부담하는 송전선로 지중화 비용의 70% 국비 지원

※ 용인·평택 반도체 클러스터 전력공급 지원 : '25년 추경안 626억원(신설)

##### ② 대규모 침투단지 인프라 정부 지원한도 2배 상향

○ **(현황)** 국가첨단전략산업 특화단지(이하 '침투단지') 인프라 지원 비용이 단지별 500억원 한도로 기업 부담규모에 비해 부족

- 용인 일반산단 자체 폐수처리시설 약 3.9조원, 평택 일반산단 자체 변전소 설치 약 2,200억원 소요 등 기업 비용부담 과다

\* 도로·용수 등 인프라 약 3조원 지원 既 발표('24.6월)

⇒ **(지원방안)** 투자규모 100조원 이상 대규모 클러스터\*는 전력·용수 등 인프라 국비지원 한도 상향(최대 500→최대 1,000억원)

\* (예) 평택캠퍼스(120조원), 용인 국가산단(360조원), 용인 일반산단(122조원) 등

※ 국가첨단전략산업특화단지 기반시설 지원구축 : '25년 252억원 → 추경안 +1,170억원

### ③ **첨특단지 인프라 정부 지원비율 상향**

- **(현황)** '23.7월 첨특단지 지정 후 기반시설 지원기준을 마련('24.3월)하여 기반시설 구축비용의 15~30% 지원 중
  - 첨단전략산업 글로벌 경쟁 격화, 대규모 투자 촉진 필요성 등 고려 시 첨특단지 인프라 정부 지원비율 상향 필요
  - '24.6월 바이오 특화단지 추가지정(인천·시흥, 대전 등 5개소)에 따라 바이오 분야 기반시설 지원기준 마련 필요

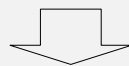
⇒ **(지원방안)** 첨특단지 인프라 구축비용의 최대 50% 국비지원, 바이오 첨특단지 인프라 지원기준을 신설

- 인프라 국비지원 비율을 현행 15~30% → 30~50%로 상향

< 첨특단지 인프라 국비지원 비율 >

구분	단지별 투자 규모			비수도권	수도권
	반도체	디스플레이	이차전지		
上	100조원 이상	30조원 이상	10조원 이상	30%	25%
中	10~100조원	3~30조원	1~10조원	25%	20%
下	10조원 미만	3조원 미만	1조원 미만	20%	15%

\* 단지별 국비지원 한도 : 일괄 500억원



구분	단지별 투자 규모				비수도권	수도권
	반도체	디스플레이	이차전지	바이오(신설)		
上	100조원 이상	30조원 이상	10조원 이상	5조원 이상	<b>50%</b>	<b>40%</b>
下	100조원 미만	30조원 미만	10조원 미만	5조원 미만	<b>40%</b>	<b>30%</b>

\* 단지별 국비지원 한도 : (투자규모 100조원 이상) 1,000억원, (그외) 500억원

※ 국가첨단전략산업특화단지 기반시설 지원구축 : '25년 252억원 → 추경안 +1,170억원



## 2. 소재 · 부품 · 장비 투자 지원

### ① 첨단 소재 · 부품 · 장비 중소·중견기업 투자보조금 신설 신규

- **(현황)** 우리 첨단전략산업 핵심품목의 미·네·일 등 의존도\* 高  
→ 취약한 소부장 경쟁력은 공급망 리스크로 연결

\* (예) 반도체 장비 점유율('23) : (미) 41% (네) 25% (일) 22% (중) 4%

- 최근 미-중 무역갈등 심화 등 산업 공급망 구축 필요성 증대

⇒ **(지원방안)** 국가첨단전략산업 공급망 안정품목·전략물자를 생산하는 중소·중견기업 대상 투자보조금 신설

- 입지·설비 신규 투자규모의 30~50% 지원(건당 150억, 기업당 200억 限)

지역	중소기업	중견기업
비수도권(국비 60%)	50%	40%
수도권(국비 40%)	40%	30%

※ 매출액, 신용등급, 투자금액·기간, 고용인원 등 고려해 지원기업 선정

※ 국가첨단전략산업 소부장 투자보조금 : '25년 추경안 700억원(신설)

### ② 50조원 규모 첨단전략산업기금 조성(반도체 17→20조원 투자) 신규

- **(현황)** 그간의 소규모, 대출중심 등 한계를 극복하고, 대규모·종합적 금융지원 위해 50조원 규모 첨단전략산업기금 도입(3.5일)
- 정부보증채 및 산은 출연 통해 재원을 마련하고, 초저리대출, 지분투자, 후순위보강 등 수요자가 원하는 방식으로 적극지원
- 산은법 개정안(3.27일 발의), 국가채무보증 동의안 국회 통과 추진 중

⇒ **(지원방안)** 산은법·국가채무보증 동의안 통과 후 즉시 세부 운영 방안을 발표하고, 최소한의 준비기간(3개월) 거쳐 기금 집행 개시

- 기존 반도체 저리대출(17조원)을 3조원 이상 추가공급하여 반도체 분야에 20조원 이상 투자('25~'27년)

\* 반도체 저리대출은 첨단전략산업기금으로 통합 예정

- 기금 출연 등 산은 본연의 적극적 정책금융 수행에 대한 재정건전성 지원 위해 필요시 재정출자 검토

### ③ 반도체 분야 중소기업에 대한 기술보증 확대

- **(현황)** 반도체 분야(소부장, 패키징, 제조 등) 신규 투자에 대해 **저리대출**(산은 일반대출 대비 최대 △1.5%p 우대) 지원중('24.7월~)
- 다만, 기업 보증한도 소진으로 실제 대출에 애로 발생

#### ⇒ **(지원방안)** 반도체 분야 중소기업 기술보증 지원 확대

- 일반 반도체 분야도 차세대 반도체 분야 수준으로 보증비율 상향 지원(現 기본 85% → 95% 이상)
- 반도체 분야는 기술보증 한도 확대(現 최대 100→200억원)

### ④ 반도체 투자세액공제율 +5%p 상향

- **(현황)** 반도체 등 국가전략기술 투자에 대해 기본 15~25% 세액공제 및 증가분에 대한 10% 추가공제 지원 중

#### ⇒ **(지원방안)** '25.1.1일 이후 발생하는 반도체 투자에 대해서는 국가전략기술 대비 세액공제율 5%p 상향 적용

※ '25.2.27일 본회의 통과 → '25.3.14일부터 시행 中

< 투자세액공제율 현황 >

구분	당기분(기본공제)			증가분* (추가공제)
	대기업	중견기업	중소기업	
일 반	1%	5%	10%	10%
신성장·원천기술	3%	6%	12%	
국가전략기술	15%		25%	
<b>반도체</b>	<b>20%</b>		<b>30%</b>	

\* (당해연도 투자액) - (직전 3년 평균 투자액)

### 3. 차세대 반도체 개발

#### ① 팹리스 기업이 자유롭게 활용가능한 **고성능 장비** 대폭 확충

- **(현황)** AI 반도체 등 첨단 시스템 반도체의 복잡도 증가로 시제품 제작 전·후 성능 검증 위한 장비 필요
  - 다만, 장비 구축에 막대한 비용\*이 소요되어 영세 팹리스 기업은 장비 구매 및 설치·사용에 한계

\* (예) 美 C社 검증장비 대당 100억원 수준 → 국내 대기업은 50대 이상 구비

⇒ **(지원방안)** 주로 대기업이 보유한 고가의 AI 반도체 실증장비를 팹리스들이 공동 활용할 수 있도록 공공 인프라 내 구축 확대

- 시제품 제작 전 설계 오류 최소화 위한 검증 장비\* 추가구축 (現 1대, 대당 약 70억원, '26년~)

\* 디지털트윈 방식의 가상 환경을 구축하여 설계상 오류가 없는지 검증

- 시제품 제작 후 실증\* 장비(대당 약 12억원 수준) 신규 구축('25년)

\* 시제품 제작 후 오실로스코프(신호검증기), 에러검증기 등을 통해 이상 여부 점검

※ 팹리스기업 첨단장비 공동이용지원 : '25년 72억원 → 추경안 +23억원

#### ② 첨단 반도체 양산 연계형 미니팹(트리니티팹) 신속 투자

- **(현황)** 국내 반도체 산업은 메모리 분야에 집중된 구조로서 소재·부품·장비(美·日 등이 주도) 등 연관 생태계 불균형
  - 특히, 반도체 소부장 기업의 실증·평가 환경이 실제 반도체 칩 양산 환경과 괴리되어 국내 소부장 기술 완성도 제고에 한계

⇒ **(지원방안)** 용인 반도체 클러스터 내 실제 양산 환경에 근접한 미니팹\*을 구축('25~'31년)하여 소부장 기업들의 실증 지원

\* 반도체 소재·부품·장비를 테스트할 수 있도록 반도체 前공정 생산설비 구축

- 반도체 기업-소부장 기업 간 협력으로 국내 반도체 공급망 내재화
- 미니팹을 기반으로 산학연 현장형 첨단 기술개발 및 전문 인재양성 등 K-반도체 혁신생태계(한국형 IMEC) 조성 추진

\* 해외 사례 : (미국) NY Creates, (대만) TSRI, (벨기에) IMEC, (일본) LSTC 등

- '24.11월 예타 통과 이후 차질없는 구축 위해 재정지원 확대

※ 첨단 반도체 양산 연계형 미니팹 구축(R&D) : '25~'31년 총사업비 4,469억원

### ③ 차세대 첨단 반도체 핵심 기술개발 조기 달성 지원

- **(현황)** 차세대 반도체 시장 선점 위해 핵심 기술개발 시급
  - NPU 등 AI 반도체\*의 경우 최근 성장성이 두드러지나 국내 기반 취약 → AI 반도체 팹리스에 대한 R&D 중점 지원 필요
  - \* 대규모 연산을 고성능 처리할 수 있어 다양한 AI 애플리케이션에 최적화된 반도체
  - PIM 인공지능 반도체\*의 경우 우리나라의 메모리 분야 강점을 활용한 초격차 기술 확보 지원 필요
  - \* 메모리 반도체 내 프로세서 연산기를 집적한 반도체(Processing In Memory)
  - 국산 AI반도체 기반 고성능·저전력 AI컴퓨팅 인프라 구축 위한 K-클라우드 기술개발 추진 필요

⇒ **(지원방안)** NPU 등 AI 반도체, PIM 인공지능 반도체, 첨단패키징, K-클라우드 핵심 기술개발 기간 단축 위해 적기 투자 확대\*

\* 주요 플래그십 사업 '26년 당초 연차소요 대비 +15% 이상 확대

※ (예시) 차세대 지능형 반도체 기술개발(R&D) : '25년 889억원  
PIM 인공지능 반도체 핵심기술 개발(R&D) : '25년 700억원  
반도체 첨단패키징 기술개발(R&D) : '25년 253억원  
AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발(R&D) : '25년 366억원

### ④ '스타 팹리스' 육성 지원 확대

- **(현황)** 차세대 반도체 분야에서 기술혁신 역량과 글로벌 성장 잠재력을 보유한 팹리스 20개사를 '스타 팹리스'로 선정('23.2월)
  - 그중 공모를 통해 15개사를 선정하여 반도체 설계 R&D 지원

⇒ **(지원방안)** 스타 팹리스 5개사 추가 지원('26년~, 現 15개사)

※ 전략제품 창출 글로벌 K-팹리스 육성 기술개발(R&D) : '25년 36억원

### ⑤ AI반도체 트랙레코드 확보 지원

- **(현황)** 국산 AI반도체 시장창출 위해 트랙레코드 지원\* 중(18개 과제)
  - \* 서버용(데이터센터)·온디바이스(드론·로봇, CCTV 등) AI반도체 국내외 실증 비용 지원

⇒ **(지원방안)** 국산 AI반도체 조기 상용화 위해 대규모 수요창출 중심의 트랙레코드 확보 지원 확대

※ AI반도체 실증지원 : '25년 244억원 → 추경안 +400억원  
AI반도체 해외실증지원 : '25년 54억원 → 추경안 +54억원

## 4. 우수인재 확보

### ① 국내 신진 석박사 대상 연수·연구 프로그램 신설 신규

- **(현황)** 국내 신진 연구자의 해외유출(brain-drain)을 방지하고 안정적인 국내 정착을 유도할 필요

⇒ **(지원방안)** 대학·연구기관 신진 석·박사 인력들에게 일경험이 될 수 있는 R&D 연수·연구 프로그램 신설('26년~)

- 반도체 등 첨단 분야 기업의 현장수요형 과제를 수행함으로써 기업의 기술개발과 함께 고급인재 양성 병행

### ② 해외 고급인재 유치 프로그램 신설 신규

- **(현황)** 글로벌 공동연구 확대 위해 국내연구자의 해외체류(out-bound) 지원 중이나, 해외연구자 국내체류(in-bound) 지원은 부재

⇒ **(지원방안)** 해외 우수인재 대상 in-bound 프로그램 신설('26년~)

- 첨단산업 분야의 해외 전문기술인력을 유치하여 기업 수요 맞춤형 프로그램 신설 및 국내기업 취업연계 지원
- 세계 최고수준 기관 우수연구자를 국내기업 수요 첨단기술 공동연구에 참여시키는 in-bound 프로그램 신설

### ③ 반도체 아카데미를 수도권에서 전국으로 확대

- **(현황)** 산업계 수요 맞춤형 인력양성 위해 반도체 아카데미 2개소 구축·운영 중이나, 수도권에 집중\*된 한계

\* 판교(글로벌 R&D센터), 용인(서플러스글로벌社) 등 2개 교육센터 운영 중

⇒ **(지원방안)** 지방 기업의 안정적 인재 확보 및 반도체 교육 접근성 제고 위해 비수도권 중심으로 반도체 아카데미 확충

※ 반도체 아카데미 구축 : '25년 47억원 → 추경안 +10억원

## Ⅳ. 향후 추진 계획

재정 투자 확대 과제	부처	시기
<b>1. 인프라 구축</b>		
· 반도체 메가클러스터 <b>송전선로 지중화 국비지원</b> 신설	산업부	'25.3분기
· 대규모 첨단단지 인프라 <b>정부 지원한도 상향</b>	산업부	'25.2분기
· 첨단단지 인프라 정부 지원비율 상향	산업부	'25.2분기
<b>2. 소재·부품·장비 투자 지원</b>		
· 첨단 <b>소재·부품·장비</b> 중소·중견기업 대상 <b>투자보조금</b> 신설	산업부	'25.3분기
· 50조원 규모 <b>첨단전략산업기금</b> 조성	금융위	'25.3분기
· 반도체 분야 중소기업에 대한 <b>기술보증</b> 확대	중기부	'25.2분기
· 반도체 투자세액공제율 5%p 상향	기재부	'25.1분기
<b>3. 차세대 반도체 기술개발</b>		
· 팹리스 기업이 자유롭게 활용가능한 <b>고성능 장비</b> 대폭 확충	산업부	'25.2분기
· 첨단 반도체 <b>양산 연계형 미니팹</b> 신속투자	산업부	'26.1분기
· 차세대 반도체 <b>핵심 기술개발</b> 조기달성 지원	산업부·과기부	'26.1분기
· '스타 팹리스' 육성 지원 확대	산업부	'26.2분기
· <b>SI반도체 실증 지원</b> 지속 확대	과기부	'25.2분기
<b>4. 우수인재 확보</b>		
· <b>국내 신진 석박사</b> 대상 연수·연구 프로그램 신설	산업부	'26.1분기
· 해외 <b>고급인재 국내체류</b> (in-bound) 지원 프로그램 신설	산업부	'26.1분기
· 반도체 <b>아카데미</b> 전국으로 확대	산업부	'25.3분기

## 참 고

## 반도체 제조 과정별 지원

소부장	제조(팹)	팹리스
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 소부장 중소·중견기업 투자보조금 신설</li> <li>- 신규 투자규모의 30~50% 지원 (건당 150억, 기업당 200억 한도)</li> <li>■ 양산 연계형 미니팹 신속투자</li> <li>- 용인 반도체 클러스터 內 미니팹 구축하여 소부장 기업 실증 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 송전선로 지중화 국비지원 신설</li> <li>- 기업부담분의 70% 지원</li> <li>■ 대규모 첨단단지 인프라 지원한도 상향</li> <li>- 투자규모 100조원 이상 500→1,000억원 지원</li> <li>■ 첨단단지 인프라 지원비율 상향</li> <li>- 15~30% → 30~50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 팹리스 공동활용 고성능 장비 확충</li> <li>- 검증실증장비 확충(現 1대)</li> <li>■ 차세대 첨단 반도체 기술개발 조기달성</li> <li>- 계획 대비 기간 단축</li> <li>■ 스타팹리스 육성 지원 확대</li> <li>- 現 15개사 → 20개사</li> <li>■ AI반도체 트랙레코드 확보 지원</li> <li>- 국산 AI반도체 실증 지원 과제 확대</li> </ul>

금융	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 50조원 규모 첨단전략산업기금 조성(반도체 17→20조원 투자)</li> <li>- 반도체 저리대출(17조)을 3조원 이상 추가공급하여 20조원 이상 투자('25~'27)</li> <li>■ 반도체 중소기업 기술보증 확대</li> <li>- 보증비율 85→95%으로 상향, 보증한도 100→200억으로 확대</li> </ul>
세제	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 반도체 투자세액공제율 5%p 상향</li> <li>- 他 국가전략기술 대비 5%p 상향(15~25% → 20~30%)</li> </ul>
인재 유치	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국내 신진 석박사 일경험 신설('26년~)</li> <li>- 기업 수요형 과제 수행 연구 지원(現 경력직 위주 → 신입 트랙 신설)</li> <li>■ 해외 고급인재 유치 프로그램 신설('26년~)</li> <li>- 해외 신진 석박사가 참여하는 산학연 공동프로젝트 신설</li> <li>- 세계 TOP급 연구자가 참여하는 국내 공동연구 신설</li> <li>■ 반도체 아카데미 전국으로 확대('25.하반기~)</li> <li>- 現 수도권 중심 → 비수도권으로 확대</li> </ul>